公司代码:688216 公司简称:气派科技

气派科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

无

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023年度亏损，公司拟不进行现金分红，也不送红股、不进行资本公积金转增股本。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	气派科技	688216	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	文正国	王绍乾
办公地址	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
电话	0769-89886666	0769-89886666
电子信箱	IR@chippacking.com	IR@chippacking.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司自成立以来，一直从事集成电路封装、测试业务，主要产品有MEMS、FC、5G氮化镓射频器件塑封封装、LQFP、QFN/DFN、CQFN/CDFN、CPC、SOP、SOT、TO、QIPAI、DIP、PDFN等多个系列产品共计超过250种封装形式，产品主要运用于消费电子、信息通讯、智能家居、物联网、工业自动化控制、汽车电子等多个领域。

近年，公司购置了晶圆测试设备，开始为客户提供晶圆测试服务，进一步完善了公司生产工序，为给客户提供封装测试提供一站式服务打下良好的基础。

(二)主要经营模式

公司从事集成电路封装测试一站式服务，公司首先可为客户提供晶圆测试服务，对晶圆的主要参数进行特性专业性的评估，尽可能地把不合格的芯片筛选出来；其次，公司采购引线框架、基板、丝材、装片胶和塑封树脂等原辅料，按照客户要求对其提供的晶圆芯片进行一系列内部工艺加工以及外协辅助加工，完成芯片封装测试的精密加工后将成品交还给客户，向客户收取加工费，获取收入和利润。

此外，在了解客户需求的基础上，公司会少量采购通用的晶圆，在产能允许时进行封装测试形成芯片成品，在客户有需求时将这些芯片成品销售给客户，从而获取收入及利润。公司自购芯片和客供芯片的采购模式、生产模式、销售模式、研发模式没有差别。

1.采购模式

公司设置采购部、计划部等部门，根据公司生产需要，针对集成电路封装测试加工所需的原材料、辅料、备件、包材等物料进行采购，除此之外，公司还对生产设备、外协加工服务项目进行采购。

2.生产模式

公司作为专业封装测试厂商，致力于为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试产品与服务，同时通过对生产系统的管理，对生产所需的品种和产量能够快速灵活的调整，形成了以多样化定制生产、快速切换为主的柔性化生产模式。

3.销售模式

公司销售环节采用直销模式，公司客户主要为芯片设计公司。绝大部分芯片设计公司由于本身无晶圆制造环节和封装测试环节，其自身只根据市场需求设计集成电路版图。该等芯片设计公司完成芯片设计后，将其交给晶圆代工厂制造晶圆，晶圆完工后交给公司，由公司对晶圆进行封装测试，之后芯片设计公司将公司封装测试后的集成电路销售给电子整机产品制造商，最后由电子整机产品制造商以电子整机的形式销售给终端消费者。

4.研发模式

公司主要采用自主研发模式，公司设有研发中心，全资子公司广东气派设有技术工程研究中心、企业技术中心、重点实验室，主导新技术、新工艺、新产品的研究和开发、新材料验证和导入。根据公司的发展战略和发展目标、承接政府部门的攻关项目、销售部门市场调研、客户定制等确定研发项目，经内部立项、设计和开发、反馈和纠正、产品试制、小批量试生产等阶段完成研发工作。公司也通过产学研、企业间合作等方式进行合作研发模式。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

公司主营业务为集成电路的封装测试，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的集成电路制造业（C3973），具体细分行业为集成电路封装测试业，根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司属于新一代信息技术产业中的集成电路制造。

（2）行业发展阶段及基本特点

集成电路是20世纪50年代发展起来的一种半导体微型器件，是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等特定加工工艺，按照一定的电路互联，把晶体管、电阻、电容、电感等电子元器件及连接导线，全部集成在微型硅片上，构成具有一定功能的电路，然后封装成电子微型器件，成为能执行特定电路或系统功能的微型结构。

集成电路封装测试包括封装和测试两个环节，因测试业务主要集中在封装企业中，通常统称为封装测试业。封装是指对通过测试的晶圆进行背面减薄、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立的具有完整功能的集成电路的过程。封装的目的是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，增强芯片的散热性能，以及便于将芯片端口联接到部件级（系统级）的印制电路板（PCB）、玻璃基板等，以实现电气连接，确保电路正常工作。测试主要是对芯片或集成模块的功能、性能等进行测试，通过测量、对比集成电路的输出响应和预期输出，以确定或评估集成电路元器件的功能和性能，其目的是将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的产品筛选出来，是验证设计、监控生产、保证质量、分析失效以及指导应用的重要手段。

集成电路产业诞生于美国，并迅速在欧洲、日本、韩国等地发展起来，但是随着产业的技术进步和市场发展，封装测试环节的产能已逐渐由美、欧、日等地区转移到中国台湾、中国大陆、新加坡、马来西亚和菲律宾等亚洲新兴市场区域。中国台湾地区是最早兴起集成电路专业封装测试代工模式的地区，也是目前全球最大的集成电路封装测试基地，中国大陆位居其次。

集成电路封测属于IC产业链偏下游的行业，通常封装和测试都是一体的，即做完封装后直接进行产品的测试。IDM和OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly&Test，半导体封装测试代工模式）是半导体封测产业的两种主要模式。伴随着半导体行业垂直分工趋势，OSAT模式将成为封测行业的主导模式。

封装的发展史也是芯片性能不断提高、系统不断小型化的历史。随着集成电路器件尺寸的缩小和运行速度的提高，对集成电路也提出新的更高要求。封装技术的发展大概分为五阶段，第一阶段为通孔插装型封装（TO、DIP），第二阶段为表面贴装型封装（QFP、QFN、DFN、SOP、SOT），第三阶段为球栅阵列封装(BGA)、晶圆级（WLP）和芯片级封装（CSP），第四阶段为多芯片组封装（MCM）、系统级封装（SIP）、三维立体封装（3D）、bumping，第五阶段为微电子机械系统封装(MEMS)、晶圆级系统封装-硅通孔（TSV)、倒装焊封装（FC)、表面活化室温连接(SAB)、扇出型集成电路封装(Fan-Out)、扇入型集成电路封装(Fan-in)。全球封装行业的主流技术处于以CSP、BGA为主的第三阶段，并向以系统级封装(SiP)、倒装焊封装(FC)、芯片上制作凸点(Bumping)为代表的第四阶段和第五阶段封装技术迈进。

集成电路下游应用广泛，涵盖消费电子、电力电子、交通、医疗、通讯技术、医疗、航空航天等众多领域。近年来，随着物联网、人工智能、云计算、大数据、5G、机器人等新兴应用领域的蓬勃发展，各类集成电路产品的使用场景和用量不断增长，为集成电路产业注入了新的增长动力。

从应用端来看，随着新能源汽车、人工智能、大数据、5G的快速发展，集成电路未来的需求将越来越大，集成电路的规模将持续增长。从国产替代来看，我国集成电路贸易逆差逐年增大，国产替代是未来几年的主旋律，因此，集成电路产业一直被视为国家层面的战略新兴产业，国家发展战略、行业发展规划、地方发展政策不断出台，为集成电路行业提供了财政、税收、投融资、知识产权、技术和人才等多方面的支持，推动集成电路行业的技术突破和整体提升，随之也推动了封装测试产业的快速发展。

集成电路封装测试行业的特点主要有：一是，技术密集，集成电路封装测试行业属于技术密集型产业，涉及到材料科学、电子工程、机械工程等多个学科领域的知识和技术。随着封装测试技术的不断发展，对专业人才的需求也越来越高。二是，高精度要求，集成电路封装测试过程中，对精度的要求非常高。因为封装测试直接影响到产品的性能和可靠性，所以必须使用高精度的封装和测试设备，以确保产品质量。三是，高度自动化，为了提高生产效率和产品质量，集成电路封装测试行业广泛采用自动化设备和系统。这些设备和系统可以自动完成封装、测试、分选等多个环节，提高生产效率和产品质量稳定性。四是，质量控制严格，集成电路封装测试行业对产品质量控制非常严格。因为集成电路产品广泛应用于计算机、通信、消费电子等领域，如果产品质量不过关，将会直接影响到用户的使用体验和企业的声誉。因此，封装测试企业通常会建立完善的质量管理体系，对产品质量进行全面控制。五是，竞争激烈，集成电路封装测试行业竞争激烈，市场上存在众多企业。为了在竞争中脱颖而出，企业需要不断提高技术水平、优化生产流程、降低成本、提高产品质量等方面做出努力。

（3）主要技术门槛

集成电路封装测试行业属于资金密集型、技术密集型行业，封装技术对于芯片来说是必须的，也是至关重要的。一方面，芯片必须通过封装才能与外界隔离，以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面，封装后的芯片也更便于安装和运输。封装工艺的功能包括功率分配(电源分配)、信号分配、散热通道、隔离保护和机械支持等，每一项功能都能影响芯片的性能，封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB（印制电路板）的设计和制造。因此，封装结构的设计难度、高度精密化的加工工艺是行业的主要技术门槛。

封装技术是集成电路封装测试行业的基础，涉及到芯片与封装材料的连接、封装结构的设计、封装工艺的控制等方面。这些技术需要企业具备专业的研发团队和先进的封装设备，以确保产品的质量和可靠性。测试技术是集成电路封装测试行业的核心技术之一，需要对集成电路进行全面、准确的测试，以确保产品的性能和可靠性。测试技术需要企业具备先进的测试设备和测试方法，同时需要专业的测试工程师进行测试方案的设计和实施。随着集成电路封装测试行业的发展，自动化技术的应用越来越广泛。企业需要掌握先进的自动化技术，包括自动化测试设备、自动化生产线等，以提高生产效率和产品质量稳定性。其外，集成电路封装测试行业对质量控制要求非常高，需要建立完善的质量管理体系，对产品质量进行全面控制。企业需要掌握先进的质量控制技术，包括统计过程控制、可靠性分析等，以确保产品质量符合标准。因此，封测企业需要不断提高技术水平、优化生产流程、降低成本、提高产品质量等方面做出努力，以在竞争激烈的市场中保持有力的竞争力

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在集成电路封装领域具有较强的成本控制和质量管理优势，是国内封装测试技术应用型代表企业之一，是华南地区封装品类最为齐全的内资封装企业之一。公司在产品质量、交货期、专业服务等方面赢得了客户的高度认可。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

先进封装是当前最前沿的封装形式和技术，包括倒装芯片（FC）结构的封装、圆片级封装（WLP）、2.5D封装和3D封装等。随着摩尔定律发展接近极限，先进封装可以通过小型化、薄型化、高效率、多集成等特点优化芯片性能和继续降低成本，成为"后摩尔时代"封测市场的主流。与此同时，随着物联网、汽车电子、人工智能、5G通信技术和自动驾驶等新兴应用领域的兴起，应用市场对封装工艺、产品性能、功能多样的要求越来越高，为先进封装测试产业提供了巨大的市场空间。

半导体行业因具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，叠加下游应用市场的不断兴起，半导体产业链从集成化到垂直化分工越来越明确，并经历了两次空间上的产业转移分别为垂直整合模式和IDM模式，目前正向第三次空间产业转移即专业分工模式，形成设计、制造、封测三大环节。加之国家对半导体行业的大力支持以及人才、技术、资本的产业环境不断成熟，全球半导体产业酝酿第三次产业转移，即向中国大陆转移趋势逐渐显现。由于人力成本的优势，集成电路封测业已经向中国大陆转移。

集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。近年来，为加快推进我国集成电路封装测试产业发展，国家及各级政府部门推出了一系列法规和产业政策推动行业的发展。另外，国家设立产业投资基金，主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级，支持设立地方性集成电路产业投资基金，鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。随着行业内主要法律法规、发展规划、产业政策的发布和落实，为集成电路产业的发展提供了良好的制度和政策保障，同时在财政、税收、技术和人才等多方面提供了有力支持，为集成电路封装测试企业创造了良好的经营环境。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,865,430,086.08	1,788,084,682.87	4.33	1,845,210,003.48
归属于上市公司股东的净资产	745,300,254.67	889,487,128.67	-16.21	1,001,531,733.33
营业收入	554,296,295.91	540,378,207.66	2.58	809,363,651.36
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	521,338,180.95	523,668,667.00	-0.45	780,135,447.65
归属于上市公司股东的净利润	-130,966,944.18	-58,562,694.49	不适用	134,587,375.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,617,170.51	-74,302,326.93	不适用	126,392,737.92
经营活动产生的现金流量净额	37,192,636.71	-74,033,628.87	不适用	221,364,733.96
加权平均净资产收益率（%）	-16.06	-6.15	不适用	17.30
基本每股收益（元／股）	-1.24	-0.55	不适用	1.45
稀释每股收益（元／股）	-1.24	-0.55	不适用	1.45
研发投入占营业收入的比例（%）	8.47	9.44	减少0.97个百分点	6.87

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	95,927,426.22	151,376,839.30	158,184,195.05	148,807,835.34
归属于上市公司股东的净利润	-33,632,281.61	-35,796,968.16	-31,687,265.86	-29,850,428.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-38,771,338.88	-44,951,194.21	-37,608,194.79	-32,286,442.63
经营活动产生的现金流量净额	-12,763,713.41	11,666,048.31	804,190.84	37,486,110.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								7,625
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								7,119
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）								0
前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
梁大钟	0	51,150,000	47.73	51,150,000	51,150,000	无	0	境内自然人
白瑛	0	10,800,000	10.08	10,800,000	10,800,000	无	0	境内自然人
童晓红	0	2,650,000	2.47	0	2,650,000	无	0	境内自然人
施保球	0	2,000,000	1.87	0	2,000,000	无	0	境内自然人
华创证券－兴业银行－华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-278,798	1,513,446	1.41	0	1,513,446	无	0	境内非国有法人
杨国忠	-149,800	1,500,200	1.4	0	1,500,200	无	0	境内自然人
北京昆石天利投资有限公司－宁波昆石天利创业投资合伙企业（有限合伙）	-233,124	1,339,380	1.25	0	1,339,380	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,295,123	1,295,123	1.21	0	1,295,123	无	0	境内非国有法人
深圳市昆石私募股权投资基金管理有限公司－深圳市昆石创富投资企业（有限合伙）	-123,462	843,317	0.79	0	843,317	无	0	境内非国有法人
气派科技股份有限公司－2023年员工持股计划	765,398	765,398	0.71	0	765,398	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东持股情况中，公司实际控制人梁大钟和白瑛是夫妇关系，合计持有公司57.80%股份；华创证券－兴业银行－华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划中梁大钟占62.76%的份额；白瑛女士持有气派科技股份有限公司-2023年员工持股计划2.86%的份额； 2、北京昆石天利投资有限公司－宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳市昆石私募股权投资基金管理有限公司－深圳市昆石创富投资企业（有限合伙）均为董事邓大悦先生控制的企业，合计持有公司2.04%股份； 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

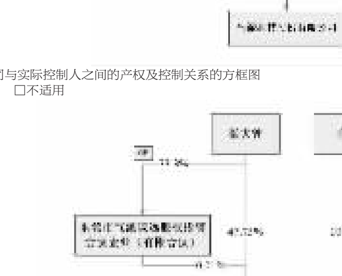
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

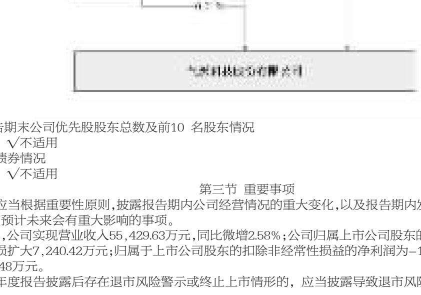
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入55,429.63万元，同比微增2.58%；公司归属上市公司股东的净利润为-13,096.69万元，同比亏损扩大7,240.42万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,361.72万元，同比亏损扩大7,931.48万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2024-012

气派科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日（星期四）以现场结合视频表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（四）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（七）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（八）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（九）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（十一）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

同意公司2023年度利润分配预案为:公司2023年度拟不进行分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-014）。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（十二）审议通过《关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

公司和控股子公司拟向各金融机构、融资租赁等机构申请累计余额不超过160,000.00万元的综合授信额度，授信额度在期限内可循环使用。

同意公司实际控制人为公司及控股子公司、公司为控股子公司、控股子公司为公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币160,000.00万元。

同意授权董事会并同意由董事会转授董事长在上述申请综合授信及贷款的总额度范围内，根据各金融机构、融资租赁等机构批准的额度，调整与各金融机构、融资租赁等机构的授信及贷款额度，同意授权董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理公司与各金融机构、融资租赁等机构的结算、融资、信用证、包含票据贴现等有关手续和签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及为提供相应担保的公告》（公告编号2024-015）。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（十三）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2024-016）。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

因审计部负责人林治广先生已达到退休年龄，为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司章程》《内部审计工作制度》的有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任祝小健先生（简历请见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于审议公司2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件:祝小健先生简历

附件:祝小健先生简历

祝小健，男，1988年4月出生，本科，中国国籍，无境外永久居住权，南华大学企业财务管理专业。

2011年3月至2012年7月任东莞市文华电子有限公司财务部出纳，2012年8月至2013年2月任东莞市文华电子有限公司财务部成本会计；2013年3月至2015年5月任中名（东莞）电子有限公司审计部专员；2015年6月至2016年5月任广东旭业光电科技股份有限公司审计部主管；2016年6月至2018年1月任公司审计部主管，2018年1月至2021年5月任公司审计部助理经理，2021年5月至2024年3月任公司行政部副经理，2024年3月至今任公司审计部经理。

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2024-013

气派科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日（星期四）以通讯表决方式召开第四届监事会第十三次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:公司监事会2023年严格遵循《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事细则》的要求，认真履行职责，对公司会议表决程序合规运作进行了监督检查，保障了公司全体股东和公司利益，有效促进了公司规范化运作。

全体监事审议通过《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（四）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司2023年不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

全体监事审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2023年度拟不进行分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案充分考虑了公司盈利状况因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，议案审议程序符合相关法律法规要求，预案符合相关法律法规的规定。

全体监事审议通过该议案。

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

全体监事审议通过《气派科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》报告内容符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告的审议程序符合法律、法规及中国证监会、交易所的规定。在年报编制过程中，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事审议通过《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

气派科技股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2024-014

气派科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技""公司"）拟定2023年度利润分配方案为:不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具"天职业字[2024] 11971号"审计报告，气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属母公司股东的净利润-130,966,944.18元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币121,322,509.91元，归属于母公司累计未分配利润72,957,770.70元。经董事会决议，公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月28日（星期四），公司召开了第四届董事会第十六次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度拟不进行分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案充分考虑了公司盈利状况因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，议案审议程序符合相关法律法规要求，预案符合相关法律法规的规定。

三、本年度不进行现金分红的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

2023年，受国际宏观经济环境、地缘政治等因素影响，终端消费市场低迷；集成电路产业受去库存、消费电子市场不景气的影响，整体呈现"供大于求"的局面，得益于大数据、人工智能、云计算、新能源汽车、物联网等为代表的新一代信息技术飞速发展的带动，集成电路行业在2023年下半年有向好的趋势。根据国家统计局公布的数据显示，2023年中国的集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，继2022年下滑后，集成电路产量再次恢复上涨趋势。中国海关总署官网最新数据显示，2023年中国累计进口集成电路4795亿颗，较2022年下降10.8%；进口金额3494亿美元，同比下降15.4%。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要业务为集成电路封装测试，主要为集成电路设计企业提供芯片封装测试服务，产品主要应用于消费电子、信息通讯、智能家居、物联网、工业自动化控制、汽车电子等。公司始终紧跟市场变化，坚持以销定产的原则，以客户需求为导向，按照保生产、保供应原则按需采购原材料。公司目前规模尚小，仍处于发展期，目前产能利用率尚未达标，公司将进一步投入资金提升自身的硬件和软件的实力，努力提升自身的市场占有率。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年，受宏观经济的影响，终端消费需求低迷，集成电路行业呈周期性下行，公司合并报表归属于上市公司股东净利润为-130,966,944.18元，较上年同期亏损扩大72,404,249.69元

为保障公司的持续健康发展，在保障公司正常运营资金外，公司拟在功率器件封测业务和晶圆测试业务继续投入，以及部分产品的产能补缺、技术改造尚需购置设备。

（四）公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，保障公司持续、稳定、健康的发展，公司提出上述分红方案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，用于部分产品的产能补缺、技术改造等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，努力实现规划目标，为投资者创造更大的价值。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素，且方案尚需提交2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2024-017

气派科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2024年3月29日

（二）股东大会召开的地点:广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,595,077
普通股股东所持有表决权数量	65,595,077
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.79
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.79

注：本次股东大会公司股份总数为107,173,500股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量256,500股、2023年员工持股计划账户股份数量765,398）为106,151,602股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

2024年第二次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；

4、见证律师李梦源律师与曹倩律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:关于控股子公司增资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	3,645,077	100	0	0	0	0

注:本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士回避了表决，共计61,950,000股。

2、议案名称:关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,595,077	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于控股子公司增资暨关联交易的议案	2,760,077	100	0	0	0	0
2	关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案	2,760,077	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1-2均为普通决议议案；

2、议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称:梁大钟先生、白瑛女士。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:李梦源律师、曹倩律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2024-015

气派科技股份有限公司关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及为提供相应担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司及控股子公司2024年度拟向金融机构、融资租赁等机构申请不超过16.00亿元综合授信额度，其中公司为控股子公司提供不超过14.00亿元的担保额度（含已授信额度），担保额度在期限内可循环使用。

● 被担保人为公司的控股子公司，具体为:广东气派科技有限公司、气派芯竞科技有限公司。

● 本次担保金额为14.00亿元，截止本公告披露之日，公司为其担保余额为7.68亿元。截止2024年3月28日，已使用未到期的授信额度金额为42,414.48万元，其中未到期长期借款金额为23,078.00万元，未到期短期借款金额为10,191.00万元，未到期的银行承兑汇票金额为7,218.08万元；未到期的信用证金额为327.41万元，未到期长期应付款金额为1,600.00万元

● 本次担保未提供反担保。

● 本次担保尚需经股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为实现2024年度的生产经营计划和目标，拓宽融资渠道，确保公司资金安全、有效周转，公司和控股子公司拟向各金融机构、融资租赁等机构申请累计余额不超过160,000.00万元的综合授信额度，综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据（含票据池）、融资租赁等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行、融资租赁等机构协商确定（最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准）。公司为控股子公司、控股子公司为公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过16.00亿元。

公司实际控制人无偿为公司及控股子公司提供相应的担保且公司及控股子公司不提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序。

公司于2024年3月28日（星期四）召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。

本次担保事项尚需股东大会审议，拟向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理公司与银行的结算、融资、信用证、包含票据贴现等有关手续和签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）广东气派科技有限公司

成立日期:2013年5月22日

注册地点:东莞市石排镇气派科技路气派大厦

法定代表人:梁大钟

注册资本:陆亿元

经营范围:集成电路的研发、测试封装、设计、销售；货物进出口、技术进出口；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构:公司持股100%

最近两年一期财务数据:

单位:万元 币别:人民币

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
资产总额	176,857.66	161,439.35	168,648.03
资产净额	79,099.82	91,708.61	97,900.23
营业收入	53,159.04	50,826.56	74,466.79
净利润	-12,673.11	-6,191.61	12,266.56
扣除非经常性损益后的净利润	-13,954.93	-7,396.53	11,612.96

以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

被担保人拥有的东府国用（2014）第特112号国有土地使用权66,670.10平方米及其上的全部房产（粤（2017）东莞不动产权第0119369号、粤（2017）东莞不动产权第0119366号等7项，合计建筑面积96,441.02平方米），抵押给中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行（一押）和中国银行股份有限公司东莞分行（二押），该抵押为公司分别向中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行申请综合授信20,000.00万元、中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信29,700.00万元，截止本公告披露之日，中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行的综合授信实际贷款金额4,500.00万元、开具银行承兑汇票5,779.59万元；中国银行股份有限公司东莞分行的综合授信实际贷款金额15,778.00万元、开具银行承兑汇票7,218.08万元。

被担保人不是失信执行人。

（二）气派芯竞科技有限公司

成立日期:2022年6月6日

注册地点:广东省东莞市石排镇石排工业大道9号1号楼

法定代表人:梁大钟

注册资本:5,000万元

经营范围:软件开发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构:公司持股99%

最近一年财务数据:

单位:万元 币别:人民币

项目	2023年12月31日/2023年度
资产总额	2,715.37
负债总额	75.64
净资产	2,639.74
营业收入	119.22
净利润	-329.38

以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司尚未签署本次担保事项的担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

被担保人为公司控股子公司，分别为公司主要生产基地及促进业务发展，其向银行申请综合授信有助于满足其日常生产经营的流动资金需求，有助于控股子公司的发展，被担保人为公司的控股子公司，因此，担保风险可控。

五、相关意见

全体董事一致同意《关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。

监事会认为:公司2024年度拟向金融机构、融资租赁申请不超过16.00亿万元的综合授信额度符合生产经营计划和目标，担保主要是为了满足公司及控股子公司的经营业务需要、确保资金安全、有效运转。经审查，控股公司生产经营情况正常，财务状况稳定，资产信用状况良好，担保风险可控。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0亿元，分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为0%、0%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为7.68亿元，分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为103.09%、41.19%；不存在逾期担保及诉讼等。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2024-016

气派科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技"或者"公司"）2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714号）核准，公司2021年6月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,570,000股，发行价为14.82元/股，募集资金总额为人民币393,767,400.00元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币55,542,826.15元，实际募集资金净额为人民币338,224,573.85元。

该次募集资金到账时间为2021年6月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月17日出具天职业字[2021]33490号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币341,884,849.27元，其中：以前年度使用305,038,440.55元，本年度使用36,846,408.72元，均投入募集资金项目。

截止2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币341,884,849.27元，募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币338,224,573.85元的差异金额为人民币3,660,275.42元，其中募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额4,486,259.38元，节余的募集资金销户转入基本存款账户金额820,994.35元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《气派科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理制度")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年度第四次临时股东大会审议通过，2020年度第二次临时股东大会第一次修订，2024年第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司东莞石排支行、上海银行股份有限公司深圳科技园支行和中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务总监签署意见，总经理审批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理办公会议或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告总经理、董事会及监事会。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司于2021年6月17日与保荐机构华创证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及其全资子公司广东气派科技有限公司，以及保荐机构华创证券有限责任公司，于2021年6月17日分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2021年7月6日与中国银行股份有限公司东莞石排支行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年8月11日，因公司将持续督导机构变更为海通证券股份有限公司，公司及其全资子公司广东气派科技有限公司，以及保荐机构海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司东莞石排支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

2023年8月3日，公司注销在中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行开立的账号为4000092829100604014的募集资金账户；2023年8月4日，公司注销在中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行开立的账号为4000092829100604262以及在上海银行股份有限公司深圳科技园支行开立的账号为03004561359的募集资金账户；2023年11月9日，公司注销在中国银行股份有限公司东莞石排支行开立的账号为669174492837的募集资金账户。至此，公司募集资金账户已经全部注销完毕，节余募集资金820,994.35元转入公司基本户，用于补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2021年7月6日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,066.54万元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。上述预先投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]34510号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年7月6日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022年4月15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年3月29日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金，不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金，不涉及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或者非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

气派科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1

气派科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期:2023年12月31日

编制单位:气派科技股份有限公司 金额单位:元

募集资金总额			338,224,573.85	本年度投入募集资金总额				36,846,408.72				
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额				341,884,849.27				
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	否	437,167,647.56	318,224,573.85	318,224,573.85	23,041,655.84	321,233,340.34	3,008,766.49	100.95	2024年6月	-20,993,384.28	不适用	否
2.研发中心（扩建）建设项目	否	48,761,684.50	20,000,000.00	20,000,000.00	13,804,752.88	20,651,508.93	651,508.93	103.26	2023年6月	不适用	不适用	否
合计		485,929,332.06	338,224,573.85	338,224,573.85	36,846,408.72	341,884,849.27	3,660,275.42	101.08				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年7月6日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金议案》同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金及预先支付的发行费用8,066.54万元。上述预先投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]34510号）。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2021年7月6日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 2022年4月15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2023年3月29日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用。								
募集资金其他使用情况				无。								

注:公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。